



WHITE PAPER

Comeback.

Was Deutschland braucht, um in der
Elektronikfertigung wieder stark zu werden
– PCB, Halbleiter, Bauteile, EMS und die Verantwortung der OEMs

Eine datengestützte Analyse mit Handlungsempfehlungen für Industrie und Politik

Dirk Kaussen, MBA

Gründer und Geschäftsführer, EMS Strategy Group

Juli 2026

Executive Summary

Deutschland ist der größte Einzelmarkt der Elektro- und Digitalindustrie in Europa. Mit rund 30 Prozent der europäischen Waferkapazitäten verfügt das Land über ein starkes Fundament in der Halbleiter-Mikroelektronik. Und dennoch droht dem Standort eine gefährliche Schiefelage: Während die Chipfertigung politisch massiv gefördert wird, bricht die nachgelagerte Elektronikwertschöpfung dramatisch ein. Der Produktionsoutput der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sank 2024 um 9,1 Prozent. Besonders alarmierend ist die Lage bei den Systemträgern: Die heimische PCB-Produktion verlor in den Jahren 2022 bis 2025 mehr als 27 Prozent ihres Umsatzes. Damit ist die europäische Leiterplattenfertigung auf weniger als 10 Prozent der Betriebsanzahl von vor 45 Jahren zusammengeschrumpft. Das sind längst keine rein konjunkturellen Schwankungen mehr – das sind ernste strukturelle Warnsignale.

Dieses White Paper stellt die entscheidende Frage: Was muss Deutschland tun, um in der gesamten Elektronikfertigung – von Leiterplatten und Bauteilen über Halbleiter bis hin zu EMS – wieder konkurrenzfähig und souverän zu werden? Die Antwort ist komplex, aber eindeutig: Es braucht ein zielgerichtetes Handeln auf drei Ebenen – Industriepolitik, Unternehmensführung und OEM-Verantwortung. Und es braucht den Mut, den bisherigen Kurs entschlossen zu korrigieren, bevor Europa dauerhaft zum Spielball geopolitischer Abhängigkeiten wird.

Kernbotschaft dieses White Papers

Deutschland verliert seinen industriellen Kern in der Elektronikfertigung – nicht plötzlich, sondern schleichend und messbar. Der Weg zurück erfordert drei Dinge gleichzeitig: staatliche Rahmenbedingungen, die mit Asien und den USA konkurrenzfähig sind; Unternehmen, die Innovationsgeist und Investitionsbereitschaft zeigen; und OEMs, die aufhören, ausschließlich über den Stückpreis zu entscheiden und stattdessen die Zukunft ihrer Lieferkette aktiv gestalten.

1. Die Ausgangslage: Zahlen, die nicht lügen

1.1 Drei Jahre Rückgang in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie

Die Zahlen des ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie – sind nüchtern und eindeutig: Die preisbereinigte Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter in Deutschland fiel 2024 um 9,1 Prozent. Die Auftragseingabe der Branche brach um 9,6 Prozent ein. Der Gesamtumsatz sank von 238 auf 223,2 Milliarden Euro – ein Rückgang von 6,2 Prozent. Die Kapazitätsauslastung lag Anfang 2025 bei nur noch 73,4 Prozent. Die Beschäftigung fiel auf 892.000 Personen, zwei Prozent unter Vorjahr.

Quelle: ZVEI, Pressemitteilung Jahresauftakt 2025, Januar 2025. ZVEI, Konjunkturdaten Dezember 2024, Februar 2025. Elektroniknet.de, Aufträge und Umsatz sind 2024 stark gesunken, Februar 2025.

ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel formuliert es direkt: „Immer deutlicher tritt zutage, dass die Probleme nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Art sind.“ Die Forderung des Verbands ist unmissverständlich: „Wir brauchen eine Effizienzwende – nicht nur technologisch, sondern insbesondere auch politisch und regulatorisch: Weniger Bürokratie, mehr Freiheit für Unternehmergeist, mehr Raum für Innovationen.“

Quelle: ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel, Jahresauftakt-Pressekonferenz, Januar 2025. ad-hoc-news.de, ZVEI erwartet 2% Produktionsminus, Januar 2025.

1.2 Die PCB-Industrie: Ein Sektor im freien Fall

Die Leiterplattenindustrie ist das schärfste Symptom des strukturellen Rückgangs. Zum 1. Januar 2025 existierten in Europa nur noch 190 Leiterplattenhersteller an 182 Standorten – weniger als 10 Prozent der Betriebsanzahl von vor 45 Jahren. Deutschland, einst Europas führender

Leiterplattenstandort, verlor zwischen 2022 und 2025 mehr als 27 Prozent seines PCB-Umsatzes. Der europäische Marktanteil an der globalen Leiterplattenproduktion liegt nur noch bei 2,2 bis 2,6 Prozent – gegenüber 15 bis 20 Prozent im Jahr 2000.

Das jüngste Signal: Im Oktober 2024 schloss Würth Elektronik sein Werk in Schopfheim – 300 Arbeitsplätze gingen verloren. Der Grund: mangelnde Rentabilität durch Energiekosten, Überregulierung und Preisdruck aus Asien. Auch die europäische Basismaterialindustrie ist nahezu verschwunden: Von einst 23 Herstellern von Laminaten und Basismaterialien sind nur noch zwei verblieben.

Quelle: all-electronics.de, Leiterplatten: Wie China Europas PCB-Markt zerstört, Oktober 2025. Data4PCB / Dieter G. Weiss, Leiterplattenindustrie wächst 2026 – aber zu wenig und langsam, all-electronics.de, März 2026. Elektroniknet.de, Wie schlimm steht es um die Leiterplattenindustrie?, November 2024.

Nicolas-Fabian Schweizer, Vorstandsvorsitzender von Schweizer Electronic und Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Printed Circuit Boards, formuliert es unmissverständlich: „Die Leiterplattenindustrie braucht Lösungen, Förderungen und Unterstützung, damit wir wieder auf Augenhöhe global wettbewerbsfähig werden. Bei uns stimmen die Rahmenbedingungen derzeit nicht. Die USA zeigen, wie es geht.“

Quelle: Nicolas-Fabian Schweizer, Interview in Elektroniknet.de, Wie schlimm steht es um die Leiterplattenindustrie?, November 2024.

1.3 Wettbewerbsfähigkeit auf historischem Tiefstand

Das ifo-Institut dokumentiert im Oktober 2025: 47 Prozent der Unternehmen in der Branche elektronische und optische Erzeugnisse meldeten eine verschlechterte Wettbewerbsposition gegenüber der Konkurrenz außerhalb der EU. Auch im europäischen Vergleich stieg der Anteil der Unternehmen mit Wettbewerbsnachteilen von 12 Prozent im Juli auf 21,5 Prozent im Oktober 2025. Die größten Einzeltreiber: Energiekosten, Überregulierung und Fachkräftemangel.

Quelle: ifo-Institut / Elektroniknet.de, Deutsche Industrie: Wettbewerbsfähigkeit so niedrig wie nie, November 2025.

2. Die strukturellen Ursachen des Rückgangs

2.1 Energiekosten als Standortnachteil

Deutschland hat die höchsten Industriestrompreise in der EU. Im europäischen Vergleich zahlen deutsche Industrieunternehmen für Strom mehr als das Doppelte des EU-Durchschnitts und rund das Drei- bis Vierfache verglichen mit US-amerikanischen Wettbewerbern. Für energieintensive Fertigungsschritte – PCB-Ätzprozesse, Galvanik, Reinraumbetrieb, Waferproduktion – ist dies ein direkter Kostennachteil, der nicht durch Produktivitätsgewinne vollständig ausgeglichen werden kann. Der Draghi-Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit (September 2024) nennt die Senkung der Energiepreise als erste strukturelle Priorität.

Quelle: Mario Draghi, Die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, Bericht an die EU-Kommission, September 2024. commission.europa.eu.

2.2 Bürokratie und Überregulierung

Nicolas-Fabian Schweizer benennt das zweite strukturelle Problem direkt: „Die Überregulierungen und die Anforderungen, die der Staat an uns stellt, haben ein Ausmaß erreicht, das zunehmend Ressourcen bindet, die dringender für den Kernbereich eines Unternehmens gebraucht werden. Wir müssen an dem sparen, was wir am dringendsten benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben: Innovationen zu entwickeln.“ Sein Appell: Für jede neue Regulierung müssen drei alte abgeschafft werden.

Der Draghi-Bericht macht 383 Reformvorschläge, deren Kern „Schluss mit der Kleinstaaterei“ in kritischen Bereichen und eine aktive Industriepolitik beinhaltet. Ein Jahr nach Veröffentlichung: Nur rund 10 Prozent der Vorschläge sind vollständig umgesetzt. Der Handlungsdruck wächst, die Umsetzungsgeschwindigkeit nicht.

Quelle: Nicolas-Fabian Schweizer, *Elektroniknet.de*, November 2024. Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, *Umsetzung des Draghi-Berichts*, November 2025.

2.3 Fachkräftemangel

Die Bundesregierung schlägt in ihrer Mikroelektronik-Strategie (Oktober 2025) einen der drei Fokuspunkte explizit auf Fachkräfte aus. Deutschland hat mit rund 30 Prozent der europäischen Waferkapazitäten den größten Mikroelektronikstandort der EU – aber fehlende Fachkräfte bremsen den Kapazitätsaufbau systematisch. Bundesministerin Dorothee Bär: „Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie, sie ist forschungsintensiv und gleichzeitig auf hochqualifizierte Fachkräfte angewiesen.“

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) / Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), *Mikroelektronik-Strategie der Bundesregierung*, Oktober 2025. *bundeswirtschaftsministerium.de*.

2.4 Fehlende Industriepolitik für PCB und EMS

Während die USA im Rahmen des CHIPS and Science Act und des Inflation Reduction Act (IRA) nicht nur Halbleiterfabriken, sondern auch Packaging, Test und Leiterplattenhersteller finanziell fördern, gibt es in der EU keine vergleichbare gezielte Förderung der PCB-Industrie. ZVEI-Präsident Kegel stellt fest: „Anders als beispielsweise in den USA gibt es für beide Industrien in der EU keine Förderung.“ Der ZVEI fordert: Die Leiterplatte muss auf der Prioritätenliste zusammen mit den Halbleitern ganz oben stehen.

Quelle: ZVEI-Studie, *Von Chips zu Chancen: Die Bedeutung und Wirtschaftlichkeit der Mikroelektronikförderung*, Dezember 2024. *zvei.org*.

3. Was Industriepolitik konkret leisten muss

3.1 Leiterplatten auf die Förderagenda

Der europäische Marktanteil an der globalen Leiterplattenproduktion liegt bei 2,2 Prozent – China und Taiwan halten zusammen rund 70 Prozent. 85 bis 90 Prozent des weltweiten PCB-Produktionsvolumens werden in Fernost hergestellt. Ohne eine gezielte Industrieförderung, wie sie die USA mit dem CHIPS Act und spezifischen PCB-Programmen betreiben, wird Europa diesen Marktanteil weiter verlieren.

Was konkret notwendig ist: Aufnahme der PCB-Industrie in den europäischen Chips Act 2.0, der nach Einschätzung von Orgalim und DIGITALEUROPE auch nachgelagerte Wertschöpfungsstufen wie Leiterplattenherstellung, Packaging und Systemintegration einschließen soll. Ebenso notwendig: Importschutzmaßnahmen analog zum US-Modell, die Nicolas-Fabian Schweizer ausdrücklich fordert: „Das wäre in Europa relativ einfach und schnell umzusetzen.“

Quelle: ZVEI, *Halbleiterförderung rechnet sich volkswirtschaftlich*, 2024. Orgalim, *Chips Act 2.0: From Crisis to Strategic Vision*, November 2025. DIGITALEUROPE, *Priorities for the Revision of the European Chips Act*, November 2025.

3.2 Energiekosten senken – Genehmigungsverfahren beschleunigen

Der Industrial Accelerator Act der EU-Kommission (März 2026) setzt an einem zentralen Strukturproblem an: zu lange Genehmigungsverfahren für strategische Industrieprojekte. Infineon hat gezeigt, dass schnelle Genehmigungen möglich sind – die Smart Power Fab in Dresden wurde mit politischem Rückenwind zügig realisiert. Was funktioniert, muss zur Regel werden, nicht zur Ausnahme. Parallel bleibt die Senkung der Industriestrompreise die dringlichste strukturpolitische Aufgabe für die Wettbewerbsfähigkeit.

Quelle: Europäische Kommission, Industrial Accelerator Act, März 2026. Infineon Technologies, Smart Power Fab Dresden, 2025. Draghi-Bericht, September 2024.

3.3 Fachkräfte: Ausbildung, Migration, Automatisierung

Die Bundesregierung hat mit ihrer Mikroelektronik-Strategie (Oktober 2025) einen Rahmen gesetzt, der auf drei Säulen basiert: Forschung, Fachkräfte, Fertigung. Konkret müssen duale Ausbildungsprogramme für SMT-Techniker, PCB-Prozessspezialisten und Leistungselektronik-Ingenieure ausgebaut werden. Gleichzeitig kann die EU-weite Fachkräftemigration einen wichtigen Beitrag leisten – der Draghi-Bericht empfiehlt explizit ein gemeinsames europäisches Zertifizierungssystem für Qualifikationen. Automatisierung ist dabei kein Gegensatz zum Fachkräfteschutz, sondern die Voraussetzung, um mit höheren Lohnkosten wettbewerbsfähig zu bleiben.

Quelle: BMW / BMFTR, Mikroelektronik-Strategie, Oktober 2025. Draghi-Bericht, September 2024.

4. Was Unternehmen selbst leisten müssen

4.1 Innovation als Überlebensstrategie

Die deutschen Stärken in der Elektronikfertigung liegen dort, wo Asien strukturell nicht mithalten kann: hochkomplexe Baugruppen, sicherheitszertifizierte Systeme, Automotive IATF-16949-Qualität, medizinische ISO-13485-Anforderungen, Spezialtechnologien wie SiC-Leistungshalbleiter. Der ZVEI-Bericht „Von Chips zu Chancen“ zeigt: Europa hat in den Bereichen Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensorik noch eine starke Marktposition. Diese Nischen müssen ausgebaut, nicht aufgegeben werden.

Konkret heißt das für EMS-Unternehmen und PCB-Hersteller: Investitionen in HDI-Technologien, in Rigid-Flex-Leiterplatten, in Advanced Packaging und in digitale Fertigungsintegration. Data4PCB-Analyst Dieter G. Weiss dokumentiert: Rigid-Flex-Leiterplatten und flexible Multilayer zeigen in Europa einen klar positiven Trend. Das sind keine Massenmärkte – das sind Hochmargenmärkte, die Europa durch technologische Führung verteidigen kann.

Quelle: ZVEI-Studie, Von Chips zu Chancen, Dezember 2024. Data4PCB / Dieter G. Weiss, all-electronics.de, März 2026.

4.2 Digitalisierung als Effizienzhebelname

Laut „Einkaufsbarometer Mittelstand 2025“ (Onventis / BME / ESB Business School) sehen 78,2 Prozent der befragten Unternehmen KI und Automatisierung als die Beschaffung der Zukunft prägend an. 80,6 Prozent identifizieren das Lieferantenmanagement als größten Digitalisierungsbedarf. 64,8 Prozent setzen auf regionales Sourcing als Resilienzmaßnahme. Diese Erkenntnisse müssen in operative Realität übersetzt werden: EMS-Unternehmen, die KI-gestützte Prozessüberwachung, digitale Traceability und automatisierte BOM-Analyse einsetzen, sind nicht nur effizienter – sie sind attraktivere Partner.

Quelle: Onventis / BME / ESB Business School, Einkaufsbarometer Mittelstand 2025, Februar 2026. beschaffung-aktuell.industrie.de.

4.3 Kooperationen und Cluster

Deutschland verfügt über exzellente Forschungsinfrastruktur – Fraunhofer-Institute, das Forschungszentrum Jülich, Universitäten mit Elektrotechnikschwerpunkten. Was fehlt, ist die konsequente Verwertung dieses Wissens in industrielle Produkte. Europa verwertet laut Draghi-Bericht nur ein Drittel seiner Patente kommerziell – gegenüber weit höheren Quoten in den USA. EMS-Unternehmen und PCB-Hersteller, die aktiv mit Forschungseinrichtungen kooperieren, sichern sich Vorsprung bei Technologien, die der Massenmarkt erst in fünf Jahren erreicht.

Quelle: Draghi-Bericht / Table.Briefings, Europas Innovationslücke – und was Deutschland jetzt tun kann, Juli 2025.

5. Die Verantwortung der OEMs

5.1 Der Preisfokus als strukturelles Problem

Nicolas-Fabian Schweizer benennt das Problem direkt: „Leider ist bei zahlreichen Kunden – auch in Europa – der Preis am Ende das allein ausschlaggebende Kriterium.“ Diese Haltung ist nicht nur kurzfristig teuer (TCO-Analyse), sie ist langfristig destruktiv: Wer europäische Fertiger ausschließlich über den Stückpreis selektiert, beschleunigt den Abbau genau der Kapazitäten, die er in der nächsten Versorgungskrise dringend benötigen wird.

Silvio Muschter, Group CTO bei Swissbit, beschreibt die Veränderung, die notwendig ist: „Für Industriekunden zählt zunehmend der gesamte Wertbeitrag eines Produkts, nicht allein der Stückpreis.“ Ein „Trusted Supply Chain“-Label gewinnt an Gewicht, unterstützt durch ESG-Kriterien und Audit-Ergebnisse. Herkunft, Produktionsstandorte und Compliance werden zu geschäftskritischen Faktoren.

Quelle: Nicolas-Fabian Schweizer, Elektroniknet.de, November 2024. Silvio Muschter (Swissbit), all-electronics.de, Fokus auf Resilienz, Regionalität und neue Lieferkettenanforderungen, Dezember 2025.

5.2 Was OEMs konkret tun können

Die Verantwortung der OEMs ist keine abstrakte Forderung – sie lässt sich konkret umsetzen:

- Bevorzugung europäischer EMS-Partner bei ähnlicher TCO-Konstellation – wer die vollständige Kostenrechnung macht, wird häufig feststellen, dass der europäische Partner kein Nachteil ist.
- Langfristige Rahmenverträge mit europäischen Partnern – laut Einkaufsbarometer 2025 setzen 72,1 Prozent der resilienten Unternehmen auf langfristige Verträge als Schutzmaßnahme.
- Aktive Beteiligung an der Kapazitätsentwicklung durch frühzeitige Vergabe – Investitionen in neue Werke (wie TLT in Litauen oder Polymatech in Estland) werden durch gesicherte Abnahme erst wirtschaftlich.
- Design-for-Manufacturability in Europa – OEMs, die ihre Entwickler frühzeitig mit europäischen EMS-Partnern vernetzen, sichern sich bessere Fertigbarkeit und kürzere Anlaufzeiten.
- Transparente Lieferkettenbewertung nach LkSG/CSDDD – wer jetzt europäische Partner aufbaut, reduziert künftigen Compliance-Aufwand strukturell.

Quelle: Onventis / BME, Einkaufsbarometer Mittelstand 2025. all-electronics.de, Fokus auf Resilienz, Dezember 2025. Nicolas-Fabian Schweizer, Elektroniknet.de, November 2024.

5.3 Der Mittelstand als Innovationsmotor

Deutschland hat eine einzigartige Struktur: einen Mittelstand mit tiefer Fachkompetenz, der weltweit in Nischen führt. Laut Handelsblatt-Ranking 2025 der wachstumsstärksten Mittelständler gilt: „Diese Unternehmen haben ein Zukunfts-Mindset verinnerlicht. Ihnen ist klar, dass sie mit mehr Unsicherheiten als früher zurechtkommen müssen, aber dass bei jeder Neuordnung auch neue Gewinnerpositionen entstehen.“

Genau das ist die Botschaft: Die globale Neuordnung der Elektronikfertigung schafft Gewinnerpositionen – für diejenigen, die jetzt handeln. Unternehmen, die in europäische Fertigung investieren, die auf Qualität und Technologie statt auf den Stückpreisvergleich setzen und die den Mut haben, mit dem Strom der Umstrukturierung zu schwimmen statt gegen ihn.

Quelle: Handelsblatt, Ranking 2025: Das sind Deutschlands wachstumsstärkste Mittelständler, Oktober 2025.

6. Was jetzt passiert: Positive Signale

Die Lage ist ernst – aber nicht hoffnungslos. Erste positive Entwicklungen sind messbar und belegt:

Maßnahme / Projekt	Akteur	Volumen / Status	Bedeutung
Smart Power Fab Dresden	Infineon Technologies	1 Mrd. EUR Förderung, Eröffnung 2026	Größte Investition in dt. Halbleiterfertigung seit Jahren
SiC-Produktion Reutlingen	Bosch	3 Mrd. EUR Gesamtinvestition	Schlüsselkomponente für E-Mobilität ab 2026 in Serie
IPCEI ME/CT	56 Unternehmen, 14 EU-Staaten	21,8 Mrd. EUR, 68 Projekte	Größtes Mikroelektronik-Förderprogramm der EU-Geschichte
Mikroelektronik-Strategie DE	Bundesregierung	Oktober 2025	Fokus Forschung, Fachkräfte, Fertigung – nationaler Rahmen
IPCEI AST	38 dt. Projekte ausgewählt	Start Beihilfeprüfung 2026	Nächste Stufe der europäischen Halbleiterförderung
TLT PCB-Werk Vilnius	Teltonika / TLT	320 Mio. EUR	Erstes neues PCB-Werk in Europa seit zwei Jahrzehnten
Industrial Accelerator Act	EU-Kommission	März 2026 veröffentlicht	Beschleunigung von Genehmigungen für strategische Industrie

Quelle: Infineon (2025), Bosch (2025), SEMI Europe / IPCEI (2025), BMW (2025), BMW IPCEI AST (März 2026), elektronikpraxis.de (TLT, November 2025), EU-Kommission Industrial Accelerator Act (März 2026).

Diese Entwicklungen sind real – aber sie sind erst der Anfang. Die Halbleiterfertigung wird gestärkt. Die EMS-Kapazität wächst in Mittel- und Osteuropa. Was noch fehlt, ist die konsequente Einbeziehung der PCB-Fertigung in die Förderprogramme und die Bereitschaft der OEMs, die entstehenden Kapazitäten durch langfristige Vergabeentscheidungen abzusichern.

7. Fazit: Es ist Zeit zu handeln – aber nicht zu warten

Deutschland kann seine führende Rolle in der Elektronikfertigung zurückgewinnen. Nicht in allen Segmenten – Massenproduktion passiver Bauelemente wird strukturell in Asien bleiben. Aber in den wertschöpfungsintensiven, technologiekritischen und sicherheitsrelevanten Bereichen hat Deutschland die Kompetenz, die Infrastruktur und das Potenzial, wieder Weltklasse zu sein.

Der Weg dorthin führt über drei Voraussetzungen, die gleichzeitig erfüllt werden müssen: Industriepolitik, die Rahmenbedingungen schafft statt zu regulieren. Unternehmen, die in Innovation und Technologie investieren statt auf den Preisverfall zu warten. Und OEMs, die aufhören, ausschließlich über den Stückpreis zu entscheiden, und stattdessen die Zukunft ihrer Lieferkette aktiv gestalten.

Der Vergleich mit der Verlagerung nach Asien vor drei Jahrzehnten ist treffend: Auch damals brauchte es einen langen Atem, politischen Willen und industrielle Pioniere. Der Unterschied heute: Wir wissen, was wir verloren haben. Und wir wissen, was wir brauchen, um es zurückzubekommen.

Handlungsempfehlung für zukunftssichere Elektronikfertigung

Wer sich in der globalen Neuordnung die besten Plätze sichern will, darf nicht warten, bis die europäischen Fertigungslinien ausgebucht sind. Gefragt sind jetzt die rechtzeitige Qualifikation regionaler EMS-Dienstleister und der Aufbau von resilienten Supply-Chain-Strukturen. Als EMS Strategy Group bringen wir genau diese Projekterfahrung ein, um OEMs partnerschaftlich abzusichern und Kapazitäten nachhaltig aufzubauen.

Quellenverzeichnis

Alle Quellen stammen aus dem Zeitraum 2024 bis Juli 2026 und sind öffentlich zugänglich.

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Pressemitteilung Jahresauftaktkonferenz, Januar 2025. [zvei.org](https://www.zvei.org)

Konjunkturdaten Dezember 2024 und Februar 2025. [zvei.org](https://www.zvei.org)

Studie: Von Chips zu Chancen: Die Bedeutung und Wirtschaftlichkeit der Mikroelektronikförderung. Dezember 2024. [zvei.org](https://www.zvei.org)

all-electronics.de / Data4PCB / Dieter G. Weiss

Leiterplatten: Wie China Europas PCB-Markt zerstört. Oktober 2025. [all-electronics.de](https://www.all-electronics.de)

Leiterplattenindustrie wächst 2026 – aber zu wenig und langsam. März 2026. [all-electronics.de](https://www.all-electronics.de)

Fokus auf Resilienz, Regionalität und neue Lieferkettenanforderungen. Dezember 2025. [all-electronics.de](https://www.all-electronics.de)

Elektroniknet.de / Markt&Technik

Wie schlimm steht es um die Leiterplattenindustrie? (Interview Nicolas-Fabian Schweizer). November 2024. [elektroniknet.de](https://www.elektroniknet.de)

Aufträge und Umsatz sind 2024 stark gesunken. Februar 2025. [elektroniknet.de](https://www.elektroniknet.de)

Deutsche Industrie: Wettbewerbsfähigkeit so niedrig wie nie. November 2025. [elektroniknet.de](https://www.elektroniknet.de)

Mario Draghi / Europäische Kommission

Die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit (Draghi-Bericht). September 2024. commission.europa.eu

Industrial Accelerator Act. März 2026. commission.europa.eu

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) / BMFTR

Bundeskabinett beschließt Mikroelektronik-Strategie. Oktober 2025. [bundeswirtschaftsministerium.de](https://www.bundeswirtschaftsministerium.de)

IPCEI Halbleiter: 38 deutsche Projekte ausgewählt. März 2026. [bundeswirtschaftsministerium.de](https://www.bundeswirtschaftsministerium.de)

Orgalim / DIGITALEUROPE / SEMI Europe

Orgalim, Chips Act 2.0: From Crisis to Strategic Vision. November 2025. [orgalim.eu](https://www.orgalim.eu)

DIGITALEUROPE, Priorities for the Revision of the European Chips Act. November 2025. [digitaleurope.org](https://www.digitaleurope.org)

SEMI Europe, Chips Act Report. Oktober 2025. [semi.org](https://www.semi.org)

Infineon Technologies / Bosch

Infineon, EU Chips Act Funding Approval – Smart Power Fab Dresden. Februar 2025. [infineon.com](https://www.infineon.com)

Bosch, Aktuell liegt unser Fokus ganz klar auf SiC. [Elektroniknet.de](https://www.elektroniknet.de), Oktober 2025.

Onventis / BME / ESB Business School

Einkaufsbarometer Mittelstand 2025. Februar 2026. [onventis.de](https://www.onventis.de)

Handelsblatt

Ranking 2025: Das sind Deutschlands wachstumsstärkste Mittelständler. Oktober 2025. [handelsblatt.com](https://www.handelsblatt.com)

elektronikpraxis.de

Großer Boost für die PCB-Fertigung in Europa: vier neue Werke von TLT. November 2025. [elektronikpraxis.de](https://www.elektronikpraxis.de)

Österreichische Gesellschaft für Europapolitik / Table.Briefings

Mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine neue Industriestrategie: Umsetzung des Draghi-Berichts. November 2025. [oegfe.at](https://www.oegfe.at)

Draghi-Report: Europas Innovationslücke – und was Deutschland jetzt tun kann. Juli 2025. [table.media](https://www.table.media)

ifo-Institut

Ifo Konjunkturtest Elektronische und optische Erzeugnisse, Oktober 2025. [ifo.de](https://www.ifo.de)

Über den Autor

Dirk Kaussen ist Gründer und Geschäftsführer der EMS Strategy Group und verfügt über nahezu 40 Jahre operative Erfahrung in der EMS-Industrie. Er gründete und leitete selbst eine Elektronikfertigung in Deutschland und kennt die Anforderungen der Elektronikfertigung daher nicht nur aus Beratungsperspektive, sondern aus eigener unternehmerischer Verantwortung. Seine Erfahrung umfasst sowohl operative Fertigungsprozesse als auch strategische Themen wie EMS-Partnerauswahl, Lieferkettenstabilität, Fertigungsverlagerung und Risikomanagement. Sein Ansatz basiert auf praxisnahen Lösungen mit direktem Bezug zur industriellen Realität.

Über die EMS Strategy Group

Die EMS Strategy Group unterstützt Industrieunternehmen bei der strategischen und operativen Weiterentwicklung ihrer Elektronikfertigung. Der Schwerpunkt liegt auf der Verlagerung von Fertigungsaufträgen zu europäischen EMS-Dienstleistern, dem Aufbau neuer Fertigungskapazitäten sowie der Erweiterung bestehender Produktionsstrukturen. Darüber hinaus begleitet die EMS Strategy Group Projekte zur Absicherung von Lieferketten durch Risikoanalysen, Dual-Sourcing-Strategien und belastbare Supply-Chain-Konzepte. Alle Projekte werden operativ begleitet und auf Wunsch bis zum vollständigen Serienhochlauf geführt. Der Fokus liegt dabei auf praxisnahen Lösungen, direkter Umsetzbarkeit und einer engen Anbindung an die industrielle Realität der Elektronikfertigung.



www.emssg.com | LinkedIn: Dirk Kaussen

© 2026 EMS Strategy Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses White Paper darf mit Quellenangabe frei zitiert werden.